

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007 年 7 月 12 日 (12.07.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/077831 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 81/02 (2006.01) C08L 77/06 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/325932
- (22) 国際出願日: 2006 年 12 月 26 日 (26.12.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2005-378130
2005 年 12 月 28 日 (28.12.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 大日本インキ化学工業株式会社 (DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1748520 東京都板橋区坂下 3 丁目 3 番 5 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 芳野 泰之 (YOSHINO, Yasuyuki) [JP/JP]; 〒2908585 千葉県市原市八幡海岸通 1 2 番地 大日本インキ化学工業株式会社 千葉工場内 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 志賀 正武, 外 (SHIGA, Masatake et al.); 〒1048453 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: HEAT-RESISTANT RESIN COMPOSITION, METHOD FOR PRODUCTION THEREOF, HEAT-RESISTANT RESIN MOLDED ARTICLE, AND SURFACE-MOUNT ELECTRONIC ELEMENT

(54) 発明の名称: 耐熱性樹脂組成物、その製造方法、耐熱性樹脂成形物、及び表面実装用電子部品

(57) Abstract: Disclosed are: a heat-resistant resin composition which has excellent heat resistance, does not show a reduced mechanical strength such as a flexural strength even after being passed through a reflow furnace and heat-treated under high temperature conditions, and also has an excellent flame retardancy; a method for production of the heat-resistant resin composition; a heat-resistant resin molded article; and a surface-mount electronic element. The heat-resistant resin composition comprises a polyarylene sulfide resin (A) and an aromatic polyamide (B) having terephthalic acid amide as an essential constituent unit at a ratio of 70/30 to 95/5 by mass. In a molded article formed from the heat-resistant resin composition, when a broken-out section of the molded article is etched with an organic solvent and subsequently observed on a scanning electron microscope (x 2500), the average diameter of voids formed by the etching is 0.1 to 1.0 μ m.

(57) 要約: 耐熱性に優れ、リフロー炉を通過させて高温条件下に加熱処理を行っても曲げ強度等の機械的強度が低下することなく、更に優れた難燃性をも兼備した耐熱性樹脂組成物、その製造方法、耐熱性樹脂成形物、及び、表面実装用電子部品を提供すること。ポリアリーレンスルフィド樹脂 (A)、テレフタル酸アミドを必須の構造単位とする芳香族ポリアミド (B) を前者/後者の質量比が 70/30 ~ 95/5 なる割合で含有し、かつ、前記耐熱性樹脂組成物からなる成形物の破断面を有機溶剤でエッチング処理した後、該破断面を走査型電子顕微鏡 (2500 倍) に観察した際、該エッチング処理によって形成された空孔の平均径が 0.1 ~ 1.0 μ m となるようにする。

WO 2007/077831 A1